

2026年9月15日

センシング技術・次世代パッケージングコンソーシアム
人・機械インタラクションWG

主査 武居 淳

副査 野村 健一、加納 伸也、古志 知也

令和8年度 第3回 人・機械インタラクションWG講演会
(ロボット小WG)のご案内

拝啓

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、当コンソーシアムのワーキンググループ活動に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。近年、製造・研究開発現場において、ロボットによるマニピュレーション技術や、データとロボットを連携させる研究 DX 技術の重要性が高まっています。今回、その応用分野の一つである「材料や部材の開発自動化」に関して、産総研内で精力的に取り組んでいる研究者による講演会を企画しました。併せてスマートラボの実験室見学会を予定しています。ご出席のほどよろしくお願いいたします。

敬具

記

日時：2026年10月26日（月）14：00～16：10（13：40受付開始）

場所：産業技術総合研究所つくば中央事業所東地区 東本館（1B棟）1階 第2会議室
(https://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/tsukuba/east/tsukuba_map_e.html)

定員：15名

14：00～14：05 開会の挨拶・趣旨説明

14：05～14：35 講演「粉末を取り扱うセラミックス実験の自動化」

産総研 材料・化学領域 マルチマテリアル研究部門 主任研究員 山口 祐貴

【概要】近年、バルク材料の開発においても、データ科学やロボティクスを活用した研究 DX が急速に進展している。本講演では、粉体を扱うセラミックス実験を対象に、自動分注ロボットを活用した室温合成可能な材料のハイスループットスクリーニングと、協働ロボットを用いた低温バルクセラミックスのプロセス最適化事例を紹介する。

14：35～14：45 講演「表面機能部材の開発」

産総研 エレクトロニクス・製造領域 製造基盤技術研究部門 主任研究員 穂苅 遼平

【概要】表面の微細構造や機能性材料を利用した表面機能部材の開発事例を紹介する。マイクロ・ナノテクノロジーを活用した機能発現の原理、製造技術、および実用化に向けた応用展開について概説する。

【概要】従来注目されてきた専用ライン型の自動化とは異なり、分散配置された既存研究設備を移動式ロボットとクラウドで連携し、研究者一人ひとりのニーズに応じた研究プロセスを柔軟に構築できるスマートラボシステムを紹介する。

16 : 10 閉会の挨拶

M-stri-SenTePack-hint-ml@aist.go.jp



開催場所: 東1B 棟
1 階 第 2 会議室



つくば中央事業所東地区 案内図